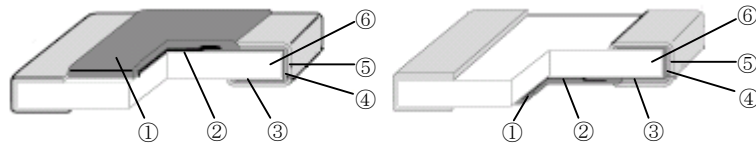
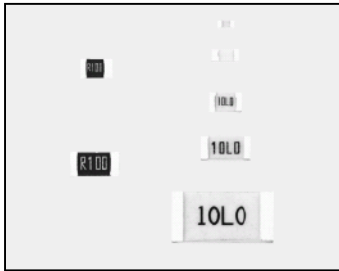


## 1. 構造図 / Construction



①	保護膜	Protective coating	④	ニッケルめっき	Ni plating
②	抵抗皮膜	Resistive film	⑤	はんだめっき	Solder plating
③	内部電極	Inner electrode	⑥	セラミック	Ceramic substrate

## 2. 欧州RoHS適合 / EU-RoHS Compliance

特定危険物質 Certain hazardous substances	最大許容濃度 (欧州 RoHS 指令) Maximum concentration values (EU-RoHS)※	判定 Judgment
Cd	<100ppm	Compliance
Cr <sup>6+</sup>	<1000ppm	Compliance
Pb	<1000ppm	Compliance
Hg	<1000ppm	Compliance
PBB	<1000ppm	Compliance
PBDE	<1000ppm	Compliance

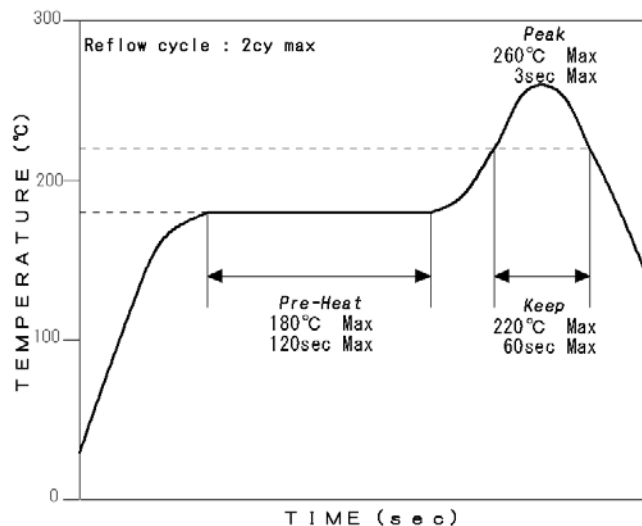
※ 均質材料の最大許容濃度 (Amending Directive 2005/618/EC)

※ Maximum concentration values by weight in homogeneous materials (Amending Directive 2005/618/EC)

電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州 RoHS 指令 (2002/95/EC) の適用除外です。  
EU-RoHS (2002/95/EC) regulation is not intended for Pb-glass contained in electrode, resistor element and glass.

## 3. 推奨はんだ付け条件及びはんだ耐熱温度 Recommended Soldering condition and resistance to soldering heat

### Recommended Soldering condition



はんだ耐熱温度(フロー) Resistance to soldering heat(Flow) : 260°C±5°C10s±1s

KOA株式会社ホームページ: <http://www.koanet.co.jp/>

製品情報ページ: <http://www.koaproducts.com/>

